はんだ上がり欠陥

【原因、判断要点、发生工序】由于 SR 网版背面玷污或者 AWF 的针孔等而引起的 (SR 图形印刷、曝光工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by a stained back side of a solder resist printing screen or a pinhole on a phototool (Solder resist application process)

## 2-3-2-2 SR エッジ厚不足/ SR 边缘厚度不足/ Insufficient solder resist thickness at a conductor edge

【特徴】回路導体エッジ部のSR厚が仕様厚に満たない状態の欠陥

【特征】在线路边缘的 SR 厚度不满足标准的缺陷。

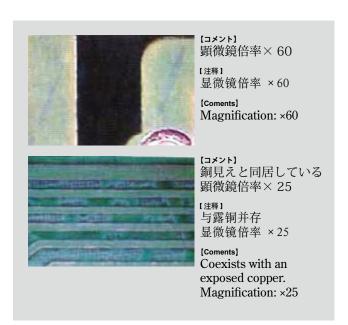
**[Characteristics]** Solder resist thickness at the conductor edge is less than a specified thickness.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R インクの粘度が低過ぎたり、印圧や印刷速度が不適切だった場合にできるもの(S R 印刷工程)

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨的粘度太低或者印刷压力、印刷速度不合适所引起的(SR 印刷工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by too low a viscosity of solder resist ink, or an improper printing pressure or squeegee speed (Solder resist printing process)



## 2-3-2-3 鉄基板 SR 傷表面微細傷/铁基板的 SR 表面的微裂痕/ Fine scratch on solder resist on iron-base printed board

【特徴】鉄基板SR表面に浅い微細な傷がある状態の欠陥

【特征】铁基板的SR表面有比较浅的细微伤痕的缺陷。

**[Characteristics]** A fine scratch exists on solder resist on an iron-base printed board.

【原因・判断ポイント・発生工程】硬化したSRの 表面に鋭利な刃物もしくは硬く微細な異物が接触し て出来たもの(SR印刷工程後)

【原因、判断要点、发生工序】硬化的 SR 表面接触锋利的刀具或者坚硬的细微杂物所引起的 (SR 印刷工序后)。

